

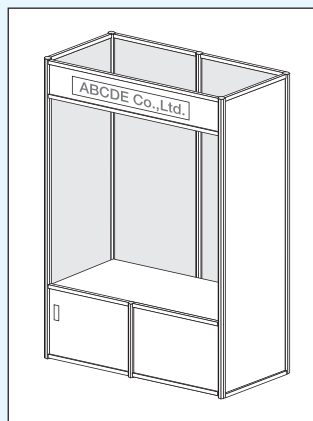
出展要項

出展料 ETWest 2016 / Smart Energy Japan 2016 in Osaka

Aブース (パッケージブース)	2m×2m=約4㎡ 270,000円 [税込]
Bブース (スペース渡し) ※4小間から申込可能	2m×2m=約4㎡ 162,000円 [税込]

小間仕様

Aブース 1小間仕様
 ・バックパネル
 ・システムカウンター
 …………… (W1950×D950×H750)
 ・バラベツ …………… (W1950×H300)
 ・社名板 …………… 一式
 ・蛍光灯 …………… 1灯
 ※展示台には片方に引き戸が付いています。
 ※コンセント(電気使用料500Wまで)をご希望の場合は別途無料にて承ります。(要申請)



※Bブースは、スペース渡しとなります。但し、4小間以上から申込み可能となります。
 ※変形形状(四辺形以外)は原則としてお受けできません。
 ※4小間以上は原則複数小間になります。単列をご希望の場合は、事務局までご相談ください。
 <Bブース申込の場合> パッケージブース、レンタル備品のご案内
 事務局では、出展社の皆様の出展サポートとして、低コストのパッケージブースプラン及び、各展示用レンタル備品をご用意しております。
 皆様の出展のご検討とあわせて、出展費用のご参考としてご確認ください。
 詳細は4月(予定)に行われる出展説明会にてご説明させていただきます。

申込期限 **2016年2月29日(月) 必着** ※ただし、満小間になり次第締め切らせていただきます。

申込について
 ■出展規約：出展申込にあたっては、別紙出展規約を遵守することを承諾した上で出展申込書を事務局宛に送付してください。
 ■出展説明会：2016年4月の開催予定です。
 ◎説明会概要
 出展要項及び出展サポートプログラムの詳細についての説明、会場仕様と小間割りの説明などを行います。※詳細につきましては後日ご案内いたします。
 ■共同出展について：複数の企業が同一ブースに出展する共同出展が可能です。ただし、社数は小間数と同数以下に限らせていただきます。共同出展社がある場合は、指定された書式で申請し、事務局の承認を得てください。事務局が承認した共同出展社は公式ホームページ等で紹介されます。

出展社セミナー

西日本の企業へのPRにご活用下さい!

出展社セミナーは展示会出展とともに、西日本の企業に向けた自社製品・ソリューションの紹介や、有望顧客の囲い込み、聴講者のブース誘導といった会期中の営業・PR活動の成果をあげるためにご活用いただけます。

【会場】展示会場に隣接したセミナールーム(100席※予定)

1枠/45分 **108,000円** [税込]

※セミナーご利用はA/Bブースいずれかをお申し込みいただいた出展社に限ります。
 ※セミナールームは、スクール形式100席(予定)、スクリーン、マイク、プロジェクター、演台が常設されております。
 ※出展社セミナーのほか、多数の出展サポートプログラム(有料)をご用意しております。詳細は事務局までお問合せください。



開催までのスケジュール

2015年 9月	2016年 2月	3月	4月	5月	6月	7月
先行予約 申込締切日 9月30日(水)	出展申込 締切日 2月29日(月)		出展社説明会 4月下旬	来場案内 配布 5月下旬	各種提出書類 締切 6月中旬	搬入・設営日 7月6日(水) 展示会開催 7月7日(木)・8日(金)

Embedded Technology 事務局
 TEL.03-3219-3563 FAX.03-3219-3628
 e-mail: etinfo@jasa.or.jp

Smart Energy Japan 展示会事務局
 TEL.03-3219-3569 FAX.03-3219-3628
 e-mail: low-cf@ics-inc.co.jp

〒101-8449 東京都千代田区猿楽町1-5-18 千代田ビル(株)ICSコンベンションデザイン内

ETWest 公式サイト <http://www.jasa.or.jp/etwest/>

SEJ in Osaka 公式サイト http://www.low-cf.jp/SEJ_Osaka

西日本で唯一の組み込み専門技術展&カンファレンス



主催：一般社団法人組み込みシステム技術協会
 企画・推進：株式会社ICSコンベンションデザイン

主催：株式会社ICSコンベンションデザイン

会期 **2016年7月7日(木)・8日(金)**
 会場 **グランフロント大阪
 コングレコンベンションセンター**



大阪中心部のグランフロント大阪で開催!



ETWest

検索



スマートエナジージャパン

検索

お問い合わせ
お申し込み



開催概要

名称: **Embedded Technology West 2016** / 組込み総合技術展 関西

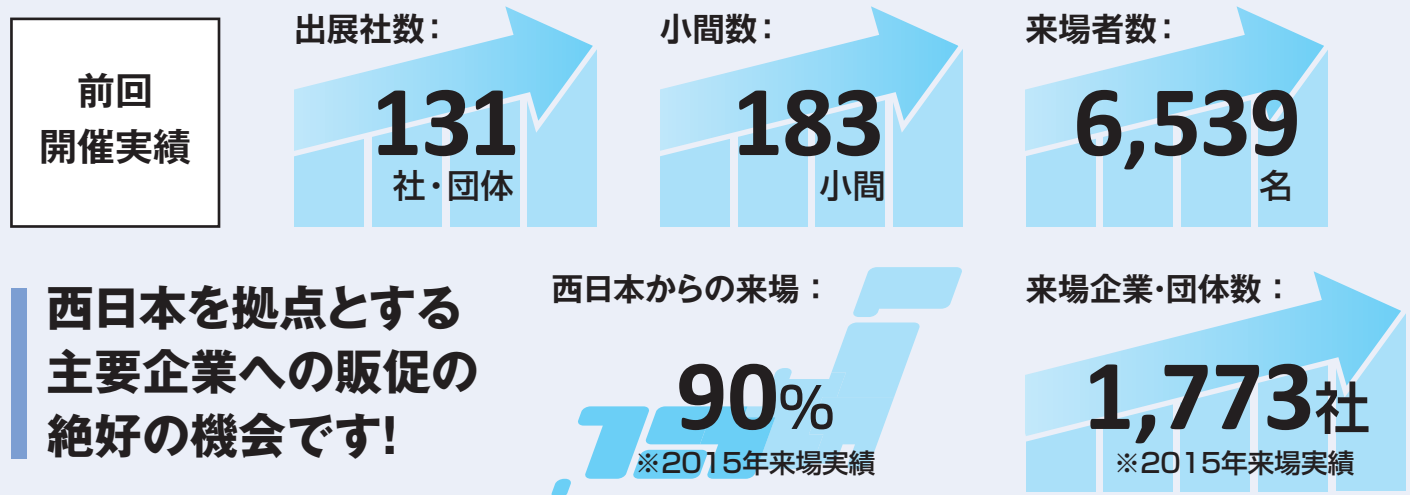
主催: 一般社団法人 組込みシステム技術協会

企画・推進: 株式会社ICSコンベンションデザイン

名称: **Smart Energy Japan 2016 in Osaka**

主催: 株式会社ICSコンベンションデザイン

会期: 2016年7月7日(木)・8日(金) 10:00~17:00 会場: グランフロント大阪 コングレコンベンションセンター



会場内風景

2015は、過去最大となる来場者で賑わいました。



カンファレンス

最新の技術動向をはじめ、多彩なテーマの無料カンファレンスを併設することで、幅広い分野の来場者を集客します。

◎基調講演

展示会コンセプト・テーマに産業界のトップ企業や官学の各分野からキーパーソンを招聘し、組込み業界として注目される旬のテーマに沿った将来展望を語ります。

◎IoTトラック

本格的なIoT時代に欠かせない知識、技術情報を厳選して紹介する、組込み技術者必見のIoT専門トラックです。

◎ヒートアップセッション

組込みシステム開発にまつわる技術課題、ビジネスビジョンなど、いま知っておきたいホットなテーマを取り上げ、聴講者とともに掘り下げていくセッションです。

◎テクニカルセッション

現場の第一線で活躍するトップレベルの技術者や専門家が、いま学んでおきたい技術テーマをじっくりレクチャーする技術セミナーです。

カンファレンス受講者数



◎スマートエネルギーセミナー

ますます重要度が高まるエネルギーの効率的な活用に向け、エネルギーの最新動向や具体的な解決策を紹介する専門セミナーです。



ETWest 出展対象と来場対象

出展社

ハードウェア・ソリューション

CPU/MCU、DSP、映像・画像処理技術、SoC、ASSP/ASIC、メモリモジュール、SSD、IPコア、FPGA/PLD、メディアプロセッサ、アナログIC(電源用、A/D、D/A等)、パワー半導体、有線/無線ネットワーク(WiFi、Bluetooth、ZigBee等)、通信インタフェース(HDMI、USB等)、NFC、RFID/ICタグ、MEMS、ラック/ソケット、ROM/Flashプログラミング装置、組込みプラットフォーム、ボードコンピュータ、産業用PC、タッチパネルディスプレイ、その他

開発環境・ツール

開発支援ツール、言語系(C/C++、Java、HTML/XML、UML、SysML、コンパイラ/アセンブラ等)、デバッグツール(ICE、エミュレータ、デバッガ、シミュレータ等)、統合開発環境、計測機器(オシロスコープ、アナライザ、分析機器、信号発生器等)、LSI設計/検証ツール、システム設計ツール、プリント基板設計ツール、コデザインツール、コペリアイケーションツール、品質管理ツール、テスト・検証サービス、EDAツール、その他

ソフトウェア・ソリューション

リアルタイムOS、組込みLinux、Android、デバイスドライバ、ファームウェア、ミドルウェア、コーデック、組込みフロント、組込みデータベース、セキュリティ関連(アンチウイルス、暗号、認証等)、ユーザビリティ関連ソリューション、その他 ソフトウェアIP、ソフトウェア部品

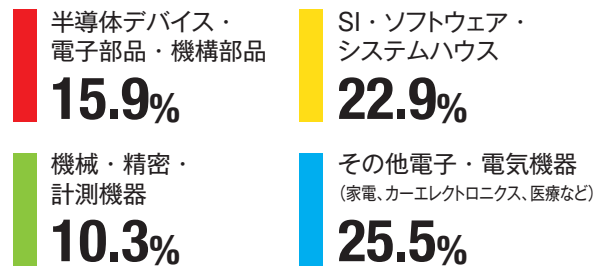
インテグレーション/デザインサービス/関連企業・団体

受託開発/コンサルティング、品質検証サービス、ROM/Flashプログラミングサービス、大学/研究機関、地方自治体/地域活動団体、標準化・技術普及団体、出版、教育/人材育成、人材派遣、その他

来場者

- 自社製品・ソリューション開発のため組込み製品を導入する幅広い分野のメーカー(技術者・マネジメント層)
※分野例: オートモーティブ、スマートエネルギー、医療/介護、社会インフラ、FA、通信/モバイル/ネットワーク など
- 機器・システムの設計や開発パートナーをお探しの組込み開発・設計を行う技術者
- 企業ニーズに合わせた製品・ソリューションを探すシステムインテグレーター

◎ETWest 来場者 主な業種



◎主な来場企業

・パナソニック	・トヨタテクニカルディベロップメント	・NTT西日本
・三菱電機	・デンソー	・NTTコミュニケーションズ
・シャープ	・ダイハツ工業	・ダイキン工業
・富士通	・アイシン精機	・村田製作所
・日本電気	・西日本旅客鉄道	・オムロン
・京セラ	・日立造船	・福西電機
・三菱重工業	・クボタ	・アイテック阪急阪神
・川崎重工業	・任天堂	
・住友電気工業	・関西テレビソフトウェア	

※過去来場実績者より一部抜粋(順不同)

Smart Energy Japan in Osaka 出展対象と来場対象

出展社

省エネルギー、エネルギー管理システム

ヒートポンプ、ボイラー、熱交換器、空調設備、新エネルギー機器、設備、システム、BEMS、FEMS、HEMS、CEMS など

エネルギー管理システム設計・開発

エネルギー管理システム受託開発、ソフトウェア/ミドルウェア、ネットワーク構築、センサネットワーク、アプリケーション開発、システムインテグレーション、家電制御システム など

エレクトロニクス/スマートエネルギー技術

センサ、PLCモジュール、デジタル電源、パワーデバイス、パワー管理IC、制御用マイコン、直流電源、蓄電デバイス、エネルギーハーベスティング、ワイヤレス給電システム、熱電変換技術、未利用エネルギー活用技術、排熱利用システム など

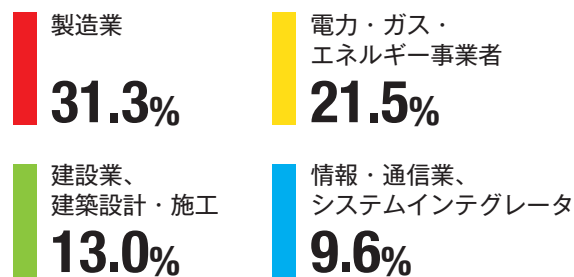
電力ビジネス

電力供給・小売サービス、電力需給管理システム、デマンドレスポンスサービス、電力事業支援ソリューション、電力事業コンサルティング、地域新電力 など

来場者

- 工場や施設の省エネルギー推進、新エネルギー導入、電力料金の削減を図りたい事業者、行政・自治体
- エネルギー機器・システムの設計や開発パートナーをお探しの技術者
- 省エネ新サービス、電力新ビジネスのアイデアや協業パートナーをお探しの方 など

◎Smart Energy Japan in Osaka 来場者 主な業種



◎主な来場企業

■ 電力、ガス、エネルギー事業者	■ 経営、総務、施設管理部門
・関西電力	・デュプロ
・中部電力	・小林製薬
・関西エネルギーソリューション	・川崎重工業
・大阪ガス	・阪神電気鉄道
・東邦ガス	・京セラ
・オリックス	・オムロン
・中央電力エナジー	・パナソニック
・エネット	・三洋製紙
・伊藤忠エクス	・タマホーム
・大和ハウス工業	・リコー
・パナソニック	・西日本電信電話
・洗剤電機 など	・ダイキン工業 など

※過去来場実績者より一部抜粋(順不同)